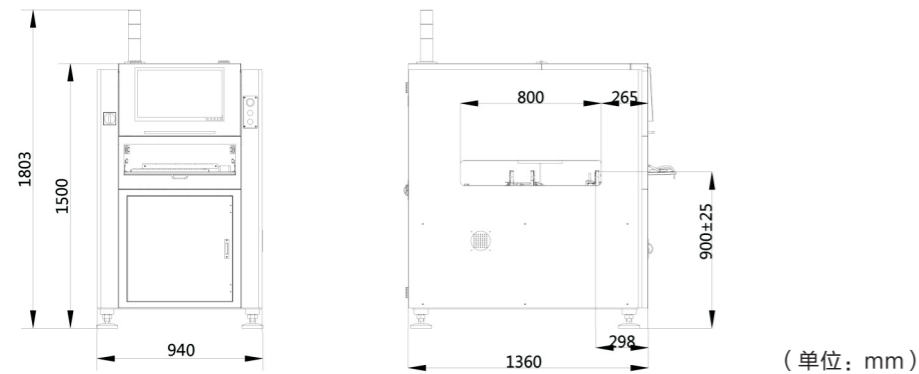


## 参数规格

| 设备型号    | V5000H      | V5000HD  | V5000S  | V5000SD                               |   |
|---------|-------------|--|---|---------------------------------------|---|
| 影像系统    | 相机          | 500万像素工业相机   |   | 1200万像素工业相机                           |   |
|         | 分辨率 (FOV大小) | 15 μm (36*30mm) / 10 μm (24*20mm) 出厂时可选                              |   | 9 μm (36*27mm) / 6 μm (24*18mm) 出厂时可选 |   |
|         | 镜头          | 远心镜头   |   |                                       |   |
|         | 光源          | 4色环形程控LED光源 (RGBW)   |   |                                       |   |
| 运动机构    | X/Y 运动      | AC 伺服马达  |   |                                       |   |
|         | 基台          | 大理石  |   |                                       |   |
|         | 轨道调宽方式      | 自动调整   |   |                                       |   |
|         | 进板流向        | 左→右或者右→左 (出厂前设定)   |   |                                       |   |
|         | 固定轨         | 前轨固定   |   |                                       |   |
| 硬件配置    | 操作系统        | WINDOWS 7  |   |                                       |   |
|         | 通信方式        | Ethernet, SPC  |   |                                       |   |
|         | 电源          | 单相200-240V, 50/60Hz, 5A  |   |                                       |   |
|         | 气压          | 0.4-0.6Mpa   |   |                                       |   |
|         | 机器尺寸        | L940*D1360*H1500mm (不含灯)   |   |                                       |   |
|         | 重量          | 750kg  | 800kg   | 750kg                                 | 800kg   |
| 检查PCB规格 | 尺寸          | 50*50-510*600mm  | 50*50-510*W<br>(W <sub>1</sub> + W <sub>2</sub> ≤ 640) mm | 50*50-510*600mm                       | 50*50-510*W<br>(W <sub>1</sub> + W <sub>2</sub> ≤ 640) mm |
|         | 厚度          | ≤6.0mm   |   |                                       |   |
|         | 板重          | 3kg  |   |                                       |   |
|         | 净高          | 上/下: 25/45mm; 上净高25-60mm可调, 下净高60mm可选                                |   |                                       |   |
|         | 工艺边         | 3.0mm  |   |                                       |   |
| 检查项目    | 锡膏          | 桥接, 偏位, 无锡, 少/多锡, 异物   |   |                                       |   |
|         | 贴装          | 桥接, 错件, 缺件, 极性, 偏位, 立碑, 反转, 破损, IC弯脚, 异物                             |   |                                       |   |
|         | 回流炉后        | 元件类: 错件, 缺件, 极性, 偏位, 立碑, 反转, 破损, IC弯脚, 异物; 焊点类: 无锡, 少/多锡, 桥接, 假焊, 锡球 |   |                                       |   |
|         | 波峰焊后        | 插入针, 无锡, 少/多锡, 孔洞, 假焊, 锡球  |   |                                       |   |
|         | 检查元件        | Chip: 03015及以上; LSI: 0.3mm间距及以上; 其他: 异型元件                            |   |                                       |   |
|         | 检查速度        | 180-200ms/FOV  |   | 180-250ms/FOV                         |   |

注: 参数规格可能会因技术改进而有变动。

## 设备尺寸



## 华中区代理商:



## 武汉协创兴业科技有限公司

地址: 武汉市东湖高新区汤逊湖北路36号新能源1栋1204室

电话: 027-87860129 传真: 027-87791830

网站: www.xctek.cn E-mail: sales@xctek.cn

V5000系列 C18-01/1

## V5000系列

高精度、高速度在线 AOI



明锐理想科技 • MagicRay Technology

MAGICray

明于心 | 锐于眼

### 先进的硬件架构

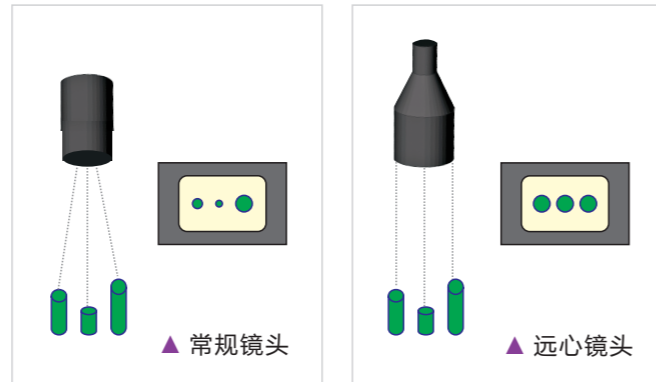
#### ■ 大理石平台及龙门

保证设备稳定性及多机共用程序一致性。



#### ■ 工业相机 + 远心镜头

整个视野内无阴影效应，使得高元件焊点检测不受影响。



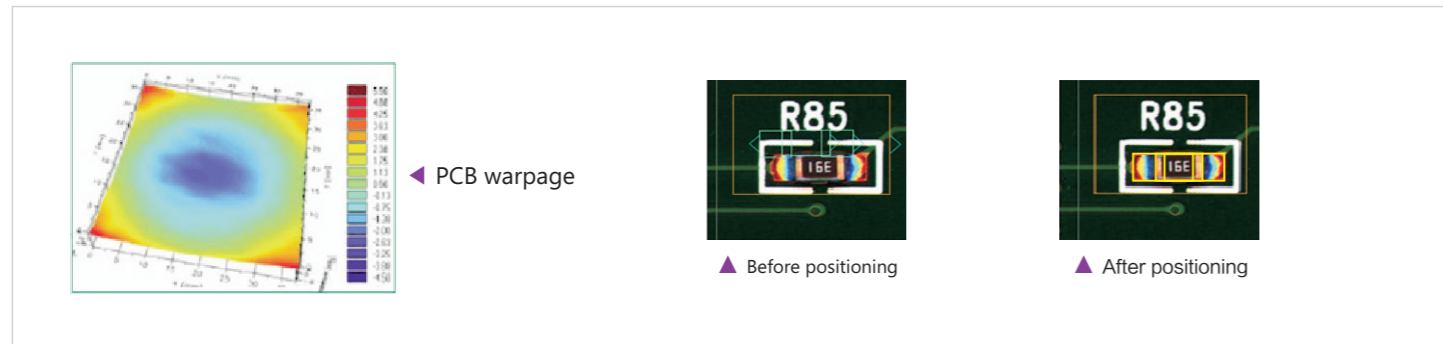
### 核心技术及优势

#### ■ 焊盘定位

焊盘定位不受板弯变形影响，特别是对于软板，不会产生大量误报。

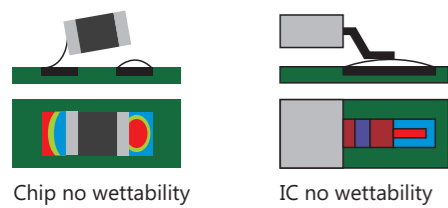
#### ■ FOV 整体辅助定位

对无外露焊盘元件（BGA 等）或被部分遮挡元件检测能力强。

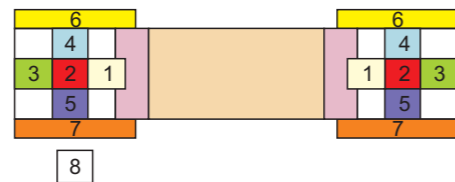


#### ■ 虚焊检查

在精准定位焊盘的基础上，对焊盘的多个特征点进行分析，无论 Chip 还是 IC 的虚焊都能有效检出。



The shape of no wettability



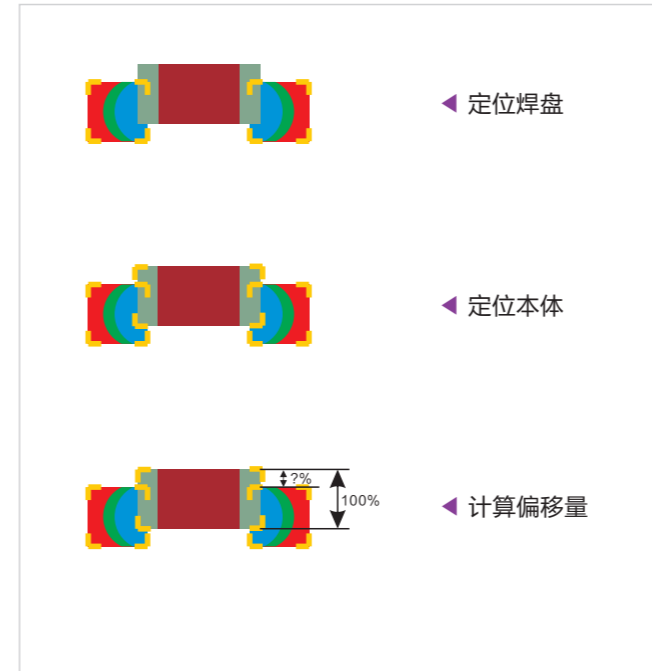
- Accurately positioning pad
- Analysis 8 feature points

### 核心技术及优势

#### ■ 检测参数与 IPC 标准直接对接

以 IPC 检验标准为参照，检测结果更加可靠。

偏移：IPC-A-610-D Class 3 元件焊端偏出焊盘部分超过焊端宽的 25% 时不可接收。



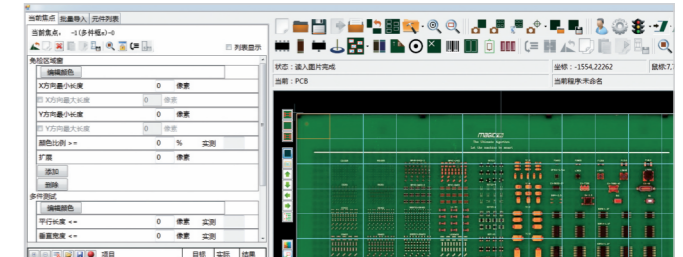
#### ■ 镭射文字检测

对于镭射文字或条码，仅利用 R/G/B 三色光会存在无法读取的问题。明锐采用独特设计的光源，能很好的对镭射文字进行检测。



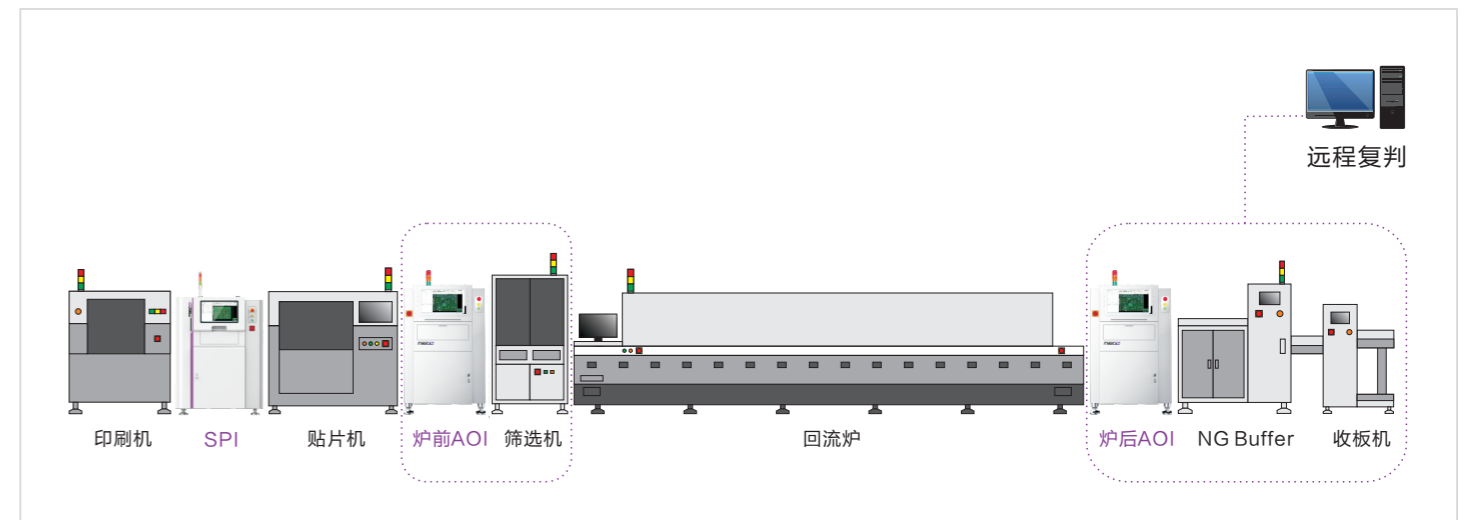
#### ■ 任意位置多件/锡珠检测

该功能可随时开启。



#### ■ 无人化智能工厂方案

与上、下游设备（筛选机、NG Buffer 及 OK/NG 收板机）进行数据互通。



#### ■ 更多优势

智能化编程（一键校正、替代料、子母程序...）；完全离线编程及实时调试；具备 DIP 件焊点专用算法；远程技术支持...